



2021年6月2日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス
代表者 代表取締役会長 三吉野 健滋
(東証マザーズ・コード番号 3782)
問合せ先 経営管理部 部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <https://www.dds.co.jp/ja/>)

汗孔と隆線を使った認証アルゴリズムに関する新特許取得のお知らせ

指紋認証を始めとした様々なセキュリティ・ソリューションを提供する株式会社ディー・ディー・エス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：久保 統義、以下 DDS）は、汗孔と隆線を使った認証アルゴリズムに関する特許を取得しましたので、お知らせいたします。

【発明の名称】 認証情報処理プログラム及び認証情報処理装置

【特許番号】 特許第6879524号

【特許権者】 株式会社ディー・ディー・エス

【出願番号】 特願2019-517533

【出願日】 2018年4月18日

【登録日】 2021年5月7日

本特許は、汗孔（かんこう）(*1)などの指紋の隆線の微細構造を解析することで認証を行う高精度の認証アルゴリズムを実現しました。汗孔をはじめとする微細構造は、従来多く利用されてきた隆線の分岐点や端点などと呼ばれる指紋の特徴点と比べ、非常に多く存在します。小さな面積のセンサーであっても、高解像度で撮影し、微細構造を抽出することで、高精度で認識を行うことができます。

◆用語の解説

*1 汗孔（かんこう）：汗が排出される出口のこと。

なお、当発表においてDDSの2021年12月期の連結業績に与える影響は精査中ではありますが、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

以上